

A

Technische Daten Leiterkartensteckverbinder

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

	BLY	SLR	BLR	SLP	BLP	SLU	SL KA, SL KG
Kontaktmaterial: Körper	CuZn-Legierung			CuSn-Legierung	CuZn-Legierung	CuSn-Legierung	CuZn-Legierung
Oberfläche der Kontakthülse: Gold/Zinn	Ni + 4 µm Sn	Ni+ 0,25 µm Au Ni+5 µm Sn	Ni+5 µm Sn	Ni+ 0,25 µm Au Ni+6 µm Sn	Ni+6 µm Sn	selektiv: Ni+0,20 µm Au Zinn: Ni+6 µm Sn	selektiv: Ni+0,25 µm Au Zinn: Ni+5 µm Sn
Innenfederkontakt: Material/Oberfläche	CuBe-Leg. Ni+ 0,25 µm Au		CuSn-Leg. Ni+ 0,75 µm Au		CuBe-Leg. Ni+ 0,75 µm Au		
Durchgangswiderstand:	≤ 10 mOhm	≤ 20 mOhm		≤ 10 mOhm		≤ 10 mOhm	≤ 20 mOhm
Schockfestigkeit:	50 g		50 g		50 g		
Vibrationsfestigkeit max.:	15 g		15 g		15 g		
Kapazität zwischen zwei benachbarten Kontakten:	≤ 0,7 pF		≤ 1,0 pF		≤ 0,3 pF		
Nennstrom:	2,5 A	1 A		2 A		3 A	
Nennspannung:	100 V DC	100 V AC 150 V DC		100 V DC	100 V AC 150 V DC	100 V DC	250 V AC
Prüfspannung:	500 V			1000 V			
Isolierkörper: Material	PA 4.6, GF	PETP		PA 4.6, GF			Polyester, GF
Temperaturbereich:	-40 °C ... +163 °C (+260 °C/1 min)	-40 °C ...+ 85 °C		-40 °C ... +163 °C (+260 °C/1 min)			-55 °C ... +125 °C
Brennbarkeitsklasse:	UL 94 V-0						
Isolationswiderstand:	> 10 ¹² Ohm						> 10 ⁸ Ohm
Steckfähigkeit für Anschlüsse:	□ 0,45...0,5 mm Ø 0,4 ... Ø 0,56 mm		Ø 0,35 ... Ø 0,45 mm		□ 0,55x 0,55 mm bis □ 0,65x0,65 mm Ø 0,65 ... 0,85 mm		
Einstecktiefe für Anschlüsse:	2,5 ... 3,8 mm		2,3 ... 3 mm		2,2 ... 6 mm		
Steck-/ Ziehkräfte, Typ:	6-Finger: 1,27 N/ 0,3 N	Haltekraft: > 2 N	1,2 N/0,6 N		6-Finger: 1,27 N/ 0,3 N		

N

G 73

Buchsenl. 2,54 Löt, durchsteckb.
Schutzkragenstiftl. f. Einpreßtechn.
Stiftleisten 1,27 SMD
Technische Daten

→ G 30
→ G 46
→ G 64
→ F 74 - 78

Präzisionsstiftleisten → G 3 - 7
Design Spezifikation für Stiftleisten → G 15
Einzelkontakte auf Metallstreifen → G 28
Kundenspez. Stift- u. Buchsenleisten → G 19